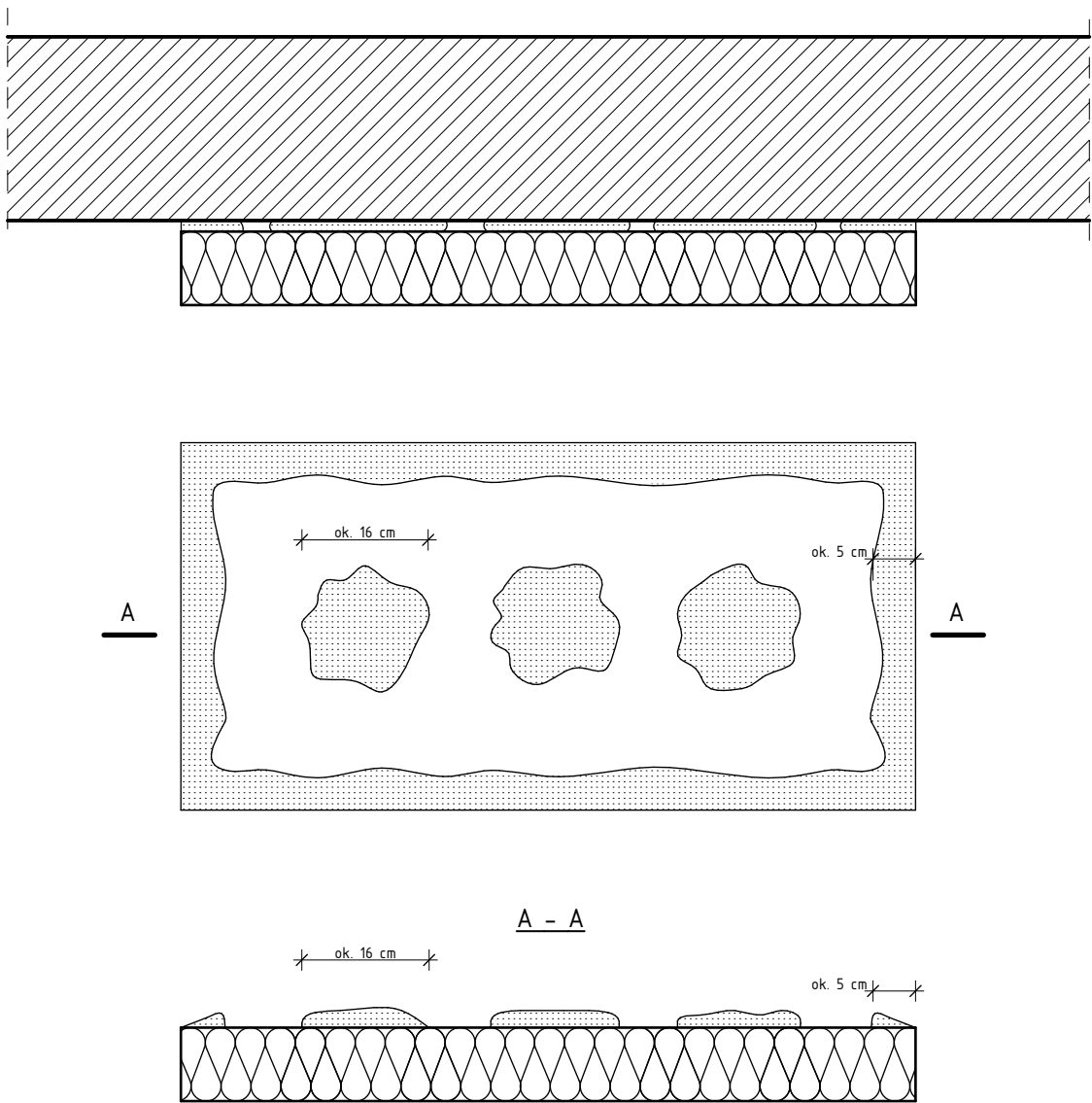



SPOSÓB KLEJENIA STYROPIANOWYCH PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ



$$\frac{P_e}{P} \times 100\% \geq 40\%$$

Pe – efektywna powierzchnia przyklejenia płyty termoizolacyjnej do podłoża  
P – powierzchnia płyty termoizolacyjnej przylegająca do ściany

**UWAGI:**  
Do klejenia izolacji termicznej używa się fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku podłoża nienasiąkliwych i drewnopochodnych, lub cementowych zapraw klejowych do zmieszania z wodą na budowie w przypadku typowych podłoży budowlanych. Zaprawę klejową należy przygotowywać według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne) również w przypadku fabrycznie przygotowanych klejów dyspersyjnych, które wymagają zmieszania z cementem celem przygotowania właściwej zaprawy klejowej. Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody obwodowo-punktowej. Na płytę nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówność podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty natożyć minimum 3 placzki zaprawy wielkości dłoni. Na równych podłożach można nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną, całopowierzchniowo przy użyciu pacy zębatej (ok. 10 mm).  
Stosowanie materiałów różnych producentów jest niedopuszczalne.

Obiekt:	PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RADYMNI		
Inwestor:	MIASTO RADYMNO UL. LWOWSKA 20, 37-550 RADYMNI		
Lokalizacja:	UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 4, 37-550 RADYMNO, DZ. 2342/19, OBR. 0001 RADYMNO	nr rys.:	A-10
Branża:	ARCHITEKTURA	skala:	1:10
Nazwa rys.:	SPOSÓB KLEJENIA STYROPIANOWYCH PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ	data:	04.2024
Projektant:	mgr inż. arch. Karol Łoziński	nr upr.:	podpis:
		MPOIA/037 /2021	
Sprawdziła:	mgr inż. arch. Katarzyna Tytuła	nr upr.:	podpis:
		15/PKOKK /2018	